****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

****

*Das conga-IT6 Mini-ITX Motherboard von congatec ist für High-End Embedded Computing Applikationen ausgelegt*

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

***Besuchen Sie uns auf der embedded world***

 ***in Nürnberg, Halle 1, Stand 358***

Pressemitteilung

congatec stellt skalierbares, prozessorunabhängiges
High-End Mini-ITX Motherboard vor

**Eines für alles: Das Embedded Motherboard
für alle High-End Applikationen**

**Deggendorf, 30. Januar 2018 \* \* \*** congatec – ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer und Embedded Design & Manufacturing Services – stellt mit dem conga-IT6 ein für High-End Applikationen ausgelegtes Embedded Motherboard im Mini-ITX Formfaktor vor, das mit seinem COM Express Typ 6 Steckplatz eine hohe Skalierbarkeit über alle gängigen Embedded Prozessoren bietet. Anwender können damit ihre Applikationen über alle relevanten Prozessorgenerationen und Herstellergrenzen hinweg bedarfsgerecht skalieren und damit stets auf dem neusten Stand des Embedded High-End Computings halten. Diese Skalierbarkeit ermöglicht flexible High-End Performanceklassen von Intel® Core i7™ und Intel® Xeon® E3 Prozessoren bis hin zur kommenden Designs – beispielsweise auf Basis der AMD Zen Architektur. Das neue Embedded Motherboard erhöht zudem den Langzeitnutzen bestehender Mini-ITX Motherboard Designs, da abgekündigte Prozessoren sehr einfach durch neue Module ohne jegliche Modifikationen am Motherboard aktualisiert werden können.

Das neue conga-IT6 Mini-ITX Motherboard, das speziell für den stets nach neuen Performanceupgrades rufenden High-End Sektor entwickelt wurde, unterstützt grundsätzlich auch alle zukünftigen Prozessoren, die congatec auf dem COM Express Type 6 Formfaktor anbietet. Aktuell reicht die Performance-Range von Intel® Atom™, Celeron® und Pentium® Prozessoren über die AMD Embedded G- und R-Series bis hin zu Intel® Core™ i7 und Xeon® E3 Prozessoren der 7. Generation. Mit letzteren wird das neue conga-IT6 zu einem extrem leistungsfähigen Mini-ITX Board mit einer Langzeitverfügbarkeit, die bislang von keinem anderen Embedded Computing Hersteller angeboten wird. Insgesamt können Kunden unter 11 unterschiedlichen Prozessorvarianten wählen.

„Neben unserem Standardproduktportfolio an industriellen Mini-ITX Boards mit gelöteten Prozessoren gibt es eine Reihe von Kunden, die funktionsidentische Embedded Motherboards mit deutlich flexiblerer Prozessorauslegung bevorzugen, weil sie stets die bestmögliche Performance integrieren wollen. Wenn sie zudem Langzeitverfügbarkeit benötigen oder hochskalierbare Produktfamilien entwickeln wollen, sind sie mit unserem neuen Embedded Mini-ITX Board bestens bedient“, erklärt Jürgen Jungbauer, Produkt Manager für Single Board Computers bei congatec. „Beispiele für solche High-End Embedded Applikationen sind Broadcasting-Equipment, Infotainment Systeme und Medical Workstations, die dank der Modulbauweise auch von einer vereinfachten Zertifizierung als Medizingerät profitieren.“

“Eine modulare Mini-ITX Plattform ist darüber hinaus auch ein großartiger Ausgangspunkt für kundenspezifische Mini-ITX Designs, da unser Embedded Design & Manufacturing Service nur noch das existierende Mini-ITX Board anpassen und die applikationsfertigen off-the-shelf Computer-on-Modules einbinden braucht, was die Time-to-Market und Kosten für kundenspezifische Mini-ITX basierte Plattformen reduziert,” ergänzt Christian Eder, Direktor Marketing bei congatec.

Der COM Express Standard spezifiziert Kühllösungen, die CPU-seitig auf das jeweils verwendete COM Express Modul optimiert sind, zur System-Seite aber ein einheitliches mechanisches Kühl-Interface darstellen. Damit ist die Kombination aus COM Express Modul mit Kühllösung bei voller Kompatibilität zum Systemdesign austauschbar. Passende passive oder aktive Kühllösungen sind für alle congatec Module verfügbar.

**Das Featureset im Detail**

Das durchweg industrietaugliche Mini-ITX Motherboard conga-IT6 für COM Express Typ 6 Module kombiniert Standard Embedded Schnittstellen mit Leistungsmerkmalen aus der IT-Welt, um die Anforderungen von leistungshungrigen Grafik-Workstations und Mini-Servern zu erfüllen. Für den Anschluss von high-performance Grafikkarten und GPGPUs steht ein PCIe Graphics Slot zur Verfügung, der je nach Modul bis zu 16 Lanes anbindet. Für weitere Peripherie stehen 4x USB sowie ein miniPCIe Port bereit. Monitore können über 2x DP, 2x HDMI sowie über eDP, LVDS und VGA Ausgänge angebunden werden. 2x 1 GbE, von denen einer über einem dedizierten Intel® i211 Netzwerkcontroller ausgeführt wird sowie ein Micro-SIM Slot bieten flexible Vernetzungsoptionen. Für Speichermedien gibt es 2x SATA Gen3 sowie einen microSD und M.2 Typ B Sockel, der das schnelle Intel® Optane™ Memory unterstützt. An Embedded Interfaces führt das Motherboard 4x COM (232/422/485), 1x GPIO (4x GPIs, 4x GPOs and 16x GPIOs), 1x I²C Bus aus. Die Stromversorgung erfolgt sehr flexibel über externe und interne Weitbereichseingänge (12 VDC bis 24 VDC) und mit Smart Battery Management Support sind sogar batteriebetriebene mobile Applikationen möglich. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör – wie I/O-Blenden, Kabelsätzen und Videoadaptern – steht zum einfacheren Design-In ebenfalls zur Verfügung.

Folgende Bestückungsvarianten stehen zur Verfügung:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modul** |  | **Prozessoren** |  | **Cores (max)** |  | **Max. Takt****[GHz]** |  | **TDP Range [W]**  |
| **conga-TS175** |  | **Intel® Core™****Intel® Xeon®** |  | **4** |  | **4,3** |  | **25 – 45** |
| **conga-TS170** |  | **Intel® Core™****Intel® Xeon®** |  | **4** |  | **4,28** |  | **25 – 45** |
| **conga-TS97** |  | **Intel® Core™****Intel® Xeon®** |  | **4** |  | **2,7****2,0** |  | **47** |
| conga-TR3 |  | AMD G-SeriesAMD R-Series |  | 24 |  | 2,03,4 |  | 12 – 1512 – 35 |
| conga-TC175 |  | Intel® Celeron®Intel® Core™ |  | 2 |  | 2,23,9 |  | 15 |
| conga-TC170 |  | Intel® Celeron®Intel® Core™ |  | 2 |  | 2,03,4 |  | 15 |
| conga-TC97 |  | Intel® Celeron®Intel® Core™ |  | 2 |  | 1,92,2 |  | 15 |
| conga-TCA5  |  | Intel® Atom™Intel® Pentium™ |  | 4 |  | 2,02,5 |  | 6 – 12 |
| conga-TCA4 |  | Intel® Atom™Intel® Pentium™ |  | 4 |  | 1,01,6 |  | 4 – 6 |
| conga-TCA3 |  | Intel® Atom™Intel® Celeron® |  | 4 |  | 1,912,0 |  | 4,3 – 10 |
| conga-TCG |  | AMD G-Series |  | 4 |  | 2,4 |  | 6 – 25 |

Weitere Informationen zu dem neuen conga-IT6 Mini-ITX Motherboard für COM Express Typ 6 Module unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/mini-itx-single-board-computer/conga-it6.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Atom, Celeron, Pentium, Core und Xeon sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*